

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 1 年 12 月 5 日 (2019.12.5)

【公表番号】特表 2018-533221 (P2018-533221A)
【公表日】平成 30 年 11 月 8 日 (2018.11.8)
【年通号数】公開・登録公報 2018-043
【出願番号】特願 2018-521509 (P2018-521509)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 10 月 23 日 (2019.10.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 2 基板に接合された第 1 基板を加工する方法であって、
第 1 基板と第 2 基板の間の界面に開口を作出する工程、
前記開口にワイヤを挿入する工程、および、
前記界面に沿って前記ワイヤを移動させて剥離前縁を伝播させ、第 1 基板を第 2 基板から剥離する工程、
を有してなる方法。

【請求項 2】

第 2 基板に接合された第 1 基板を加工する方法であって、
約 300 μm 以下の厚さを有する第 1 基板と、第 2 基板との間の界面に沿って、前記第 1 基板の臨界破壊応力より小さい引張強度を有するワイヤを移動させて剥離前縁を伝播させ、第 1 基板を第 2 基板から剥離する工程を有してなる方法。

【請求項 3】

前記ワイヤは、ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、ナイロン、及びフルオロカーボンのうち少なくとも 1 つを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

第 1 基板の剥離部分と第 2 基板の対応部分との間の少なくとも最小離間距離を維持する工程をさらに有してなる、請求項 1 または 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記最小離間距離が、前記ワイヤの直径以上である、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記ワイヤが、前記第 1 基板の臨界破壊応力より小さい第 1 引張強度を有する、請求項 1 または 3 から 5 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 7】

前記ワイヤを移動させる工程の間、剥離角を実質的に一定に維持する工程をさらに含む、請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 8】

前記ワイヤを移動させる工程の前に、第 1 基板に接合された第 2 基板に背を向けた第 1 基板の主面に、機能要素を付ける工程を含む、請求項 1 から 7 のいずれか 1 項に記載の方

法。

【請求項 9】

第 2 基板から第 1 基板の対応する内部が剥離する前に第 2 基板から第 1 基板の 1 つ以上のエッジが剥離されるように、前記ワイヤを移動させる工程の間、ワイヤが剥離前縁の形状に従うように構成される、請求項 1 から 8 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 10】

前記剥離前縁の形状は、剥離前縁の伝播方向に対して凹形である、請求項 1 から 9 のいずれか 1 項に記載の方法。